# 证券简称：灿芯股份 证券代码：688691

# 灿芯半导体（上海）股份有限公司

# 投资者关系活动记录表

#  编号：2025-001

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系****活动类别** | ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访□业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动□现场参观 □其他 |
| **参与单位名称** | 景顺长城基金、兴证全球基金、浦银安盛基金、汇丰晋信基金、永赢基金、诺安基金、国泰基金、中海基金、广发基金、宏利基金、宝盈基金、富安达基金、华宝基金、国联基金、国信永丰基金、中信保诚基金、长信基金、国泰君安资管、新华资产、人保资产、渤海人寿、博道基金、淳厚基金、民生证券、趣时资产、宏道投资、中信建投证券、兴业证券、山西证券、浙商证券、天风证券、华安证券、中邮证券、中银证券、海通证券、平安证券、国金证券 |
| **时间** | 2025年1月15日 |
| **地点** | 公司会议室 |
| **上市公司****接待人员姓名** | 董事长、总经理庄志青先生董事会秘书沈文萍女士董办工作人员石啸天、梁砚卿 |
| **投资者关系****活动主要内容****介绍** | 公司情况简要介绍：灿芯股份是一家专注于提供一站式芯片定制服务的集成电路设计服务企业。公司定位于新一代信息技术领域，自成立至今一直致力于为客户提供高价值、差异化的芯片设计服务，并以此研发形成了以大型SoC定制设计技术与半导体IP开发技术为核心的全方位技术服务体系。依托完善的技术体系与全面的设计服务能力，公司不断帮助客户高质量、高效率、低成本、低风险地完成芯片设计开发与量产上市。公司为客户提供芯片设计服务最终转化为客户品牌的芯片产品被广泛应用于物联网、工业控制、消费电子、网络通信、智慧城市、高性能计算等行业。投资者提出的主要问题及公司回复情况如下：1、系统厂商采购一站式芯片定制服务的原因？答：系统厂商面向终端应用提供硬件设备或软硬一体的整体解决方案，其直接触达终端市场需求。随着新兴应用场景的不断涌现与场景需求的差异化、个性化发展趋势，标准化的芯片产品难以满足系统厂商对产品差异化竞争、知识产权保护与供应链安全等方面的迫切诉求。当通用芯片无法满足其需求时，系统厂商则可以通过采购芯片定制服务的方式实现芯片定制。2、公司如何看待芯片设计服务市场的市场空间？答：芯片设计服务市场主要面向芯片定制服务需求，具有强定制属性，同时设计服务企业无自有品牌，相关定制芯片产品均冠以客户品牌。芯片设计服务市场的市场空间与下游设计公司及系统厂商等客户芯片定制需求息息相关。受益于国家良好的产业政策与下游芯片产品需求增长，同时面对使用者个性化需求的兴起，电子模组及设备厂商等系统厂商开始面对功能多样化挑战及成本压力，定制芯片的需求快速增长，整体而言芯片设计服务具有广阔的市场空间。3、芯片设计服务市场的进入难度如何？答：由于芯片设计服务企业需要面向不同领域进行设计，而不同领域芯片在技术特点与设计难度各不相同，需要设计服务企业针对不同领域进行长期设计积累。同时，芯片设计服务企业往往需要具备全方位的芯片设计能力才能够满足客户的一站式定制需求，而在多工艺节点上形成全方位设计能力并积累工艺诀窍需要长时间的技术积淀，进入难度较大。此外，芯片设计服务行业属于技术密集型行业，技术难度较高，且客户出于设计成本、设计风险、产品验证时间等方面的综合考虑，其针对芯片定制产品一旦选定供应商则不轻易更换，准入门槛较高。4、公司在高速接口IP领域的技术储备及研发情况？答：公司已经实现DDR、Serdes、PCIE、MIPI、ONFI、USB等较为全面的高性能接口IP研发验证及产业化，且相关IP在兼容性、最高速率等关键指标达到业内领先水平。目前，公司致力于提升公司DDR、Serdes、PCIE、MIPI、USB、ONFI等接口IP在速率、带宽、功耗等关键性能的持续提升与优化，以满足数据中心、智慧城市等应用领域对于高效互联的需求。5、公司的研发投入情况及后续的研发规划是怎样的？答：基于公司长远发展考虑，公司本年度扩大研发队伍规模、持续加大研发投入，2024年前三季度研发投入为1.11亿元，同比增长47.56%。公司未来将根据自身战略进行研发布局，始终重视研发投入及研发团队建设，持续提高公司竞争力。6、公司芯片设计业务与量产业务之间的关系？答：公司的主要经营成果来源于一站式芯片定制业务，包括芯片设计业务收入及由芯片设计业务转化形成的芯片量产业务收入，其中公司芯片量产业务是芯片设计业务的延伸。在芯片设计阶段，公司依托自身多工艺平台、多工艺节点的完整芯片设计能力，能够从芯片设计环节的任一节点介入并完成余下的全部设计工作，最终高效、低风险地完成芯片设计。在量产阶段，由于不同项目所用制造工艺节点、工艺特点各有所不同，公司依托自身量产管理能力对量产良率、周期进行动态检测及改进，满足客户产品需求。基于完善的技术体系与全面的设计服务能力，公司不断帮助客户高质量、高效率、低成本、低风险地完成芯片设计开发与量产上市。7、公司对未来发展的展望？答：公司将继续专注于为客户提供一站式芯片定制服务，致力于为客户提供高价值、差异化的解决方案。凭借成熟的行业应用解决方案、优秀的芯片架构设计能力和丰富的芯片设计经验，帮助客户高效率、高质量完成芯片的定义、设计和量产出货。未来，公司将继续坚持技术创新进步，加强对新技术的研发，不断深耕对不同工艺制程的研究，助力半导体产业的蓬勃发展。 |
| **附件清单** | 无 |
| **日期** | 2025年1月15日 |
| **关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明** | 无 |